

2020年3月期 第2四半期（2019年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2019年10月31日

内容：

- 第2四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想修正 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。

一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

台風により被災された皆さまへ

被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

代表取締役社長・CEO

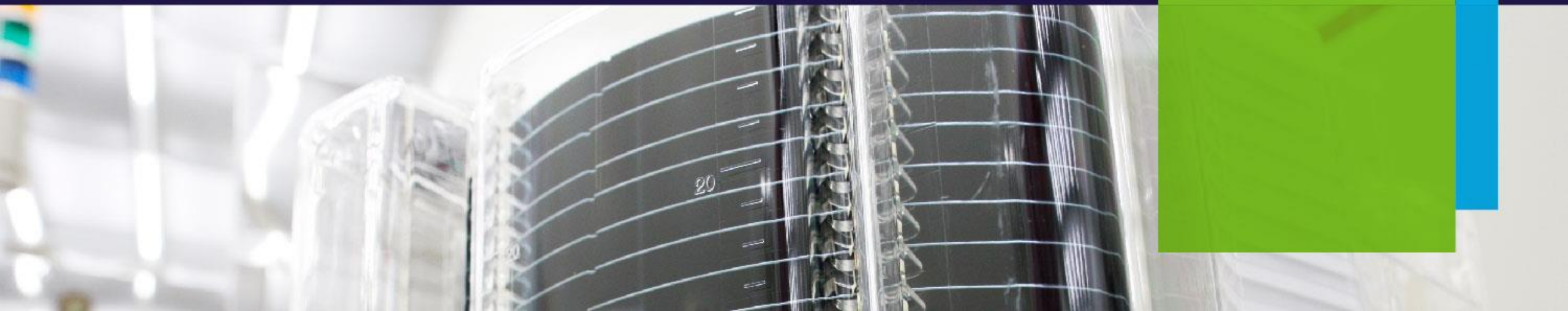
Handwritten signature in black ink, reading "谷利樹" (Tetsuya Tani).

第2四半期 連結決算の概要

2019年10月31日

布川 好一

取締役 専務執行役員 ファイナンス本部長



FY2020 上期（2019年4月～9月）ハイライト

- 売上は5,084億円、営業利益率は20.2%
 - SPE*1の一部で売上が前倒し、FS*2事業も好調。予想を上回って着地
 - 加えて、新規に獲得した工程での売上も貢献し、利益率も予想を上回った
- 上期実績と最新の情報を反映し、通期業績予想を修正
- 2019年5月以降 635万株の自己株式を取得済み
(2019年9月30日時点)
 - 取得価額の総額は1,045億円
 - 1,500億円の上限に対し、進捗率は70%

損益状況（半期）

（億円）

	FY2019		FY2020	対前年H1 増減率	（ご参考） 4月26日発表の FY2020 H1予想
	H1	H2	H1		
売上高	6,910	5,872	5,084	-26.4%	4,900
SPE	6,384	5,283	4,700	-26.4%	4,500
FPD	524	587	383	-26.9%	400
売上総利益	2,841	2,420	2,045	-28.0%	1,920
下段：売上総利益率	41.1%	41.2%	40.2%	-0.9pts	39.2%
販管費	1,086	1,069	1,020	-6.1%	1,070
営業利益	1,754	1,351	1,024	-41.6%	850
下段：営業利益率	25.4%	23.0%	20.2%	-5.2pts	17.3%
税金等調整前当期純利益	1,811	1,404	1,066	-41.1%	850
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,352	1,129	787	-41.8%	630
研究開発費	573	566	568	-0.8%	
設備投資額	229	268	296	+29.3%	
減価償却費	107	136	128	+19.7%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

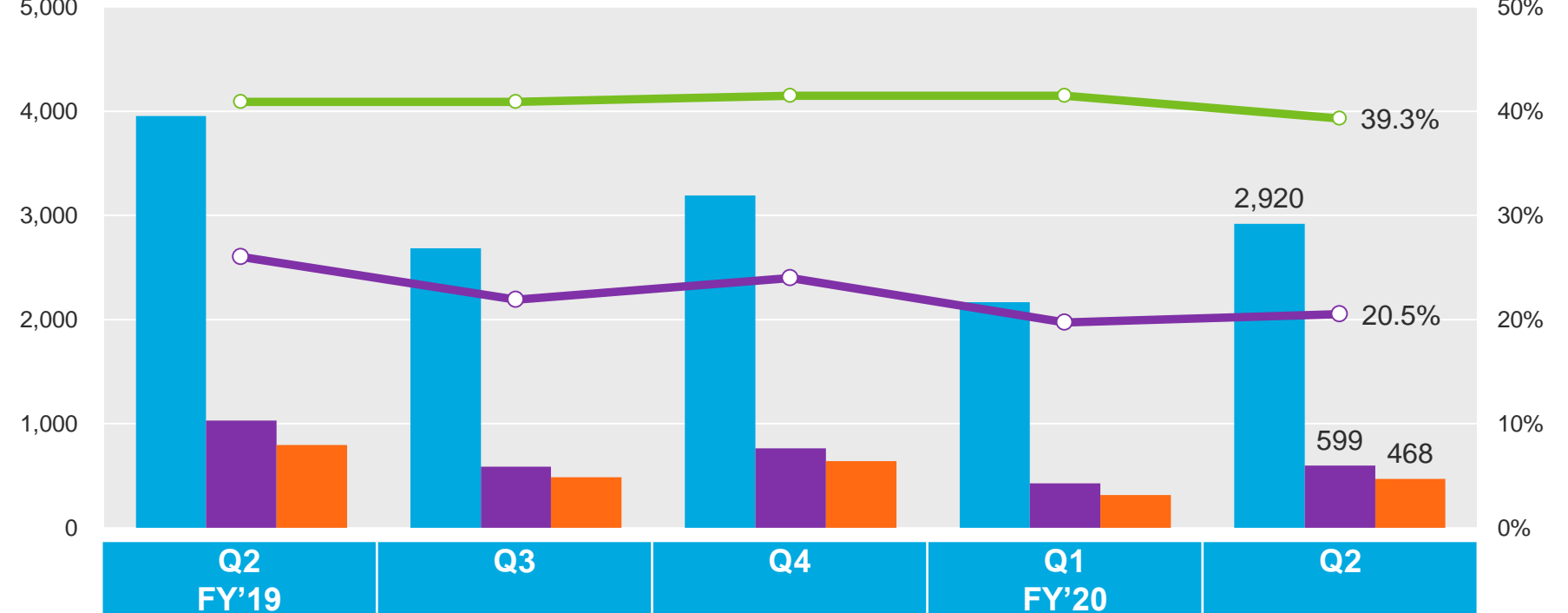
（億円）

	FY2019			FY2020		対FY2020 Q1 増減率
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
売上高	3,954	2,681	3,190	2,164	2,920	+34.9%
SPE	3,580	2,395	2,887	1,981	2,718	+37.2%
FPD	373	285	301	182	201	+10.3%
売上総利益	1,616	1,097	1,322	898	1,146	+27.5%
下段：売上総利益率	40.9%	40.9%	41.5%	41.5%	39.3%	-2.2pts
販管費	586	510	558	473	547	+15.6%
営業利益	1,030	587	764	425	599	+40.8%
下段：営業利益率	26.0%	21.9%	24.0%	19.7%	20.5%	+0.8pts
税金等調整前当期純利益	1,058	605	798	445	620	+39.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	795	488	641	318	468	+46.8%
研究開発費	312	265	300	256	312	+21.5%
設備投資額	132	118	149	76	220	+188.2%
減価償却費	56	62	73	60	67	+11.1%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

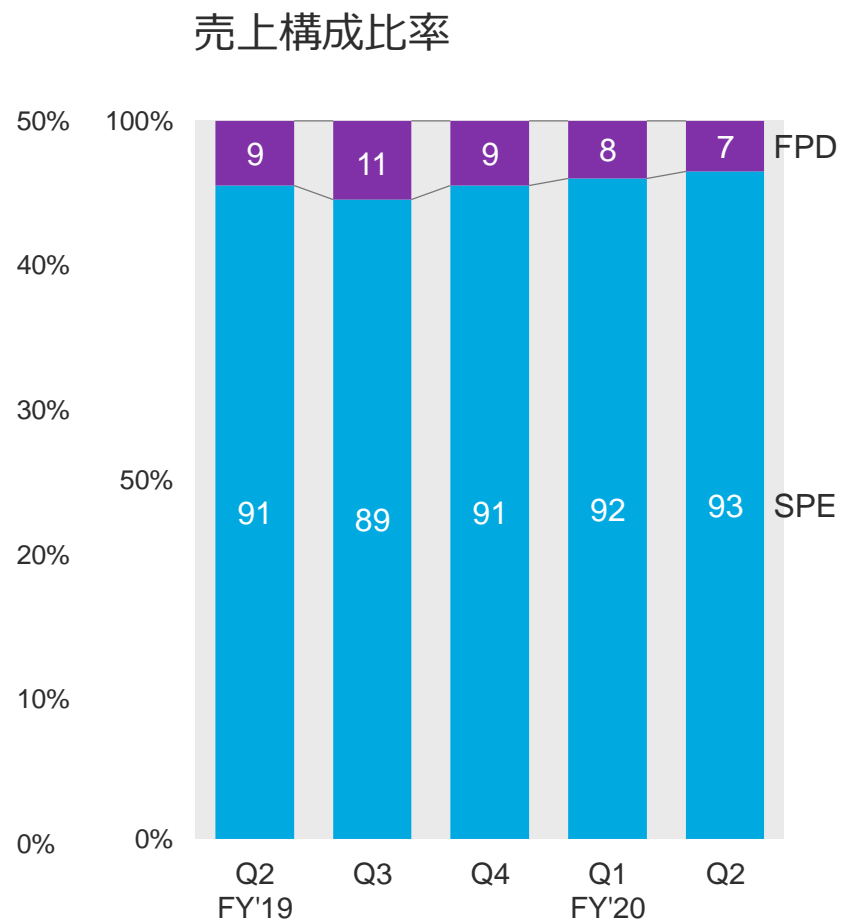
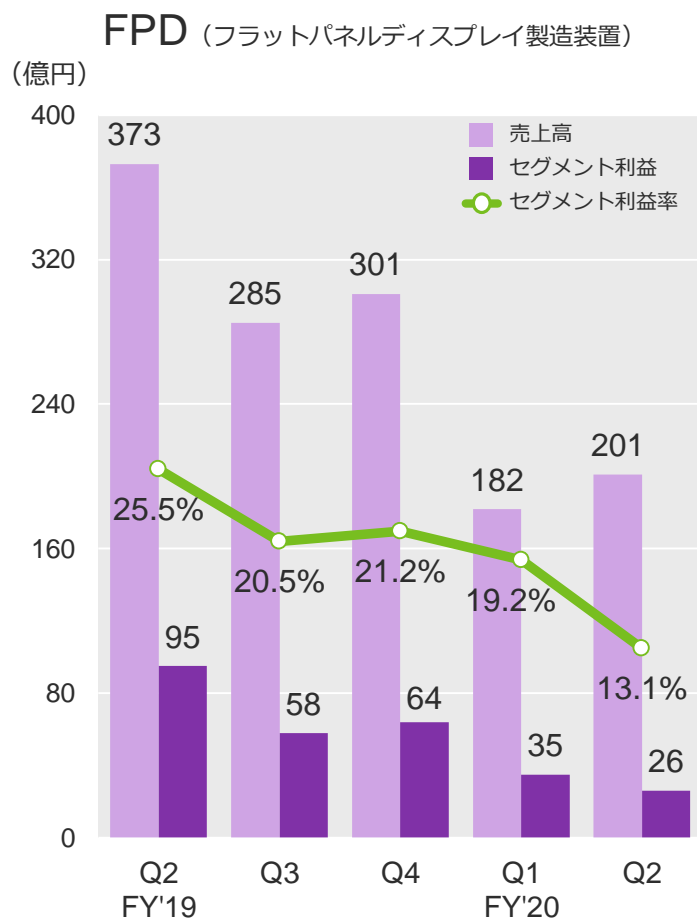
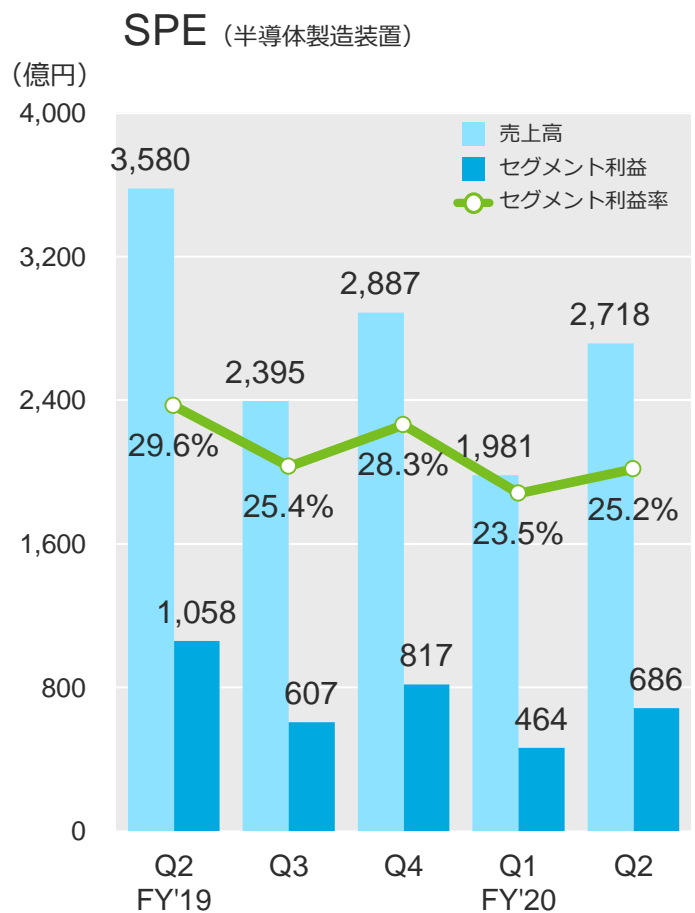
損益状況 (四半期)

(億円)
5,000



■ 売上高	3,954	2,681	3,190	2,164	2,920
■ 営業利益	1,030	587	764	425	599
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	795	488	641	318	468
○ 売上総利益率	40.9%	40.9%	41.5%	41.5%	39.3%
○ 営業利益率	26.0%	21.9%	24.0%	19.7%	20.5%

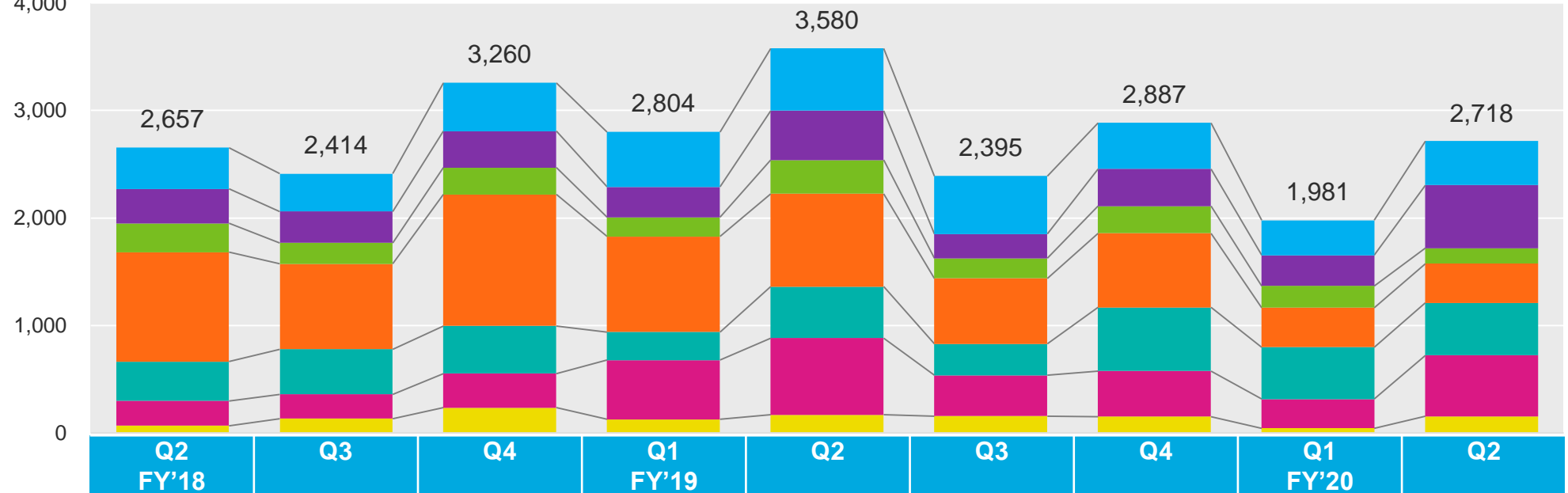
セグメント情報（四半期）



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

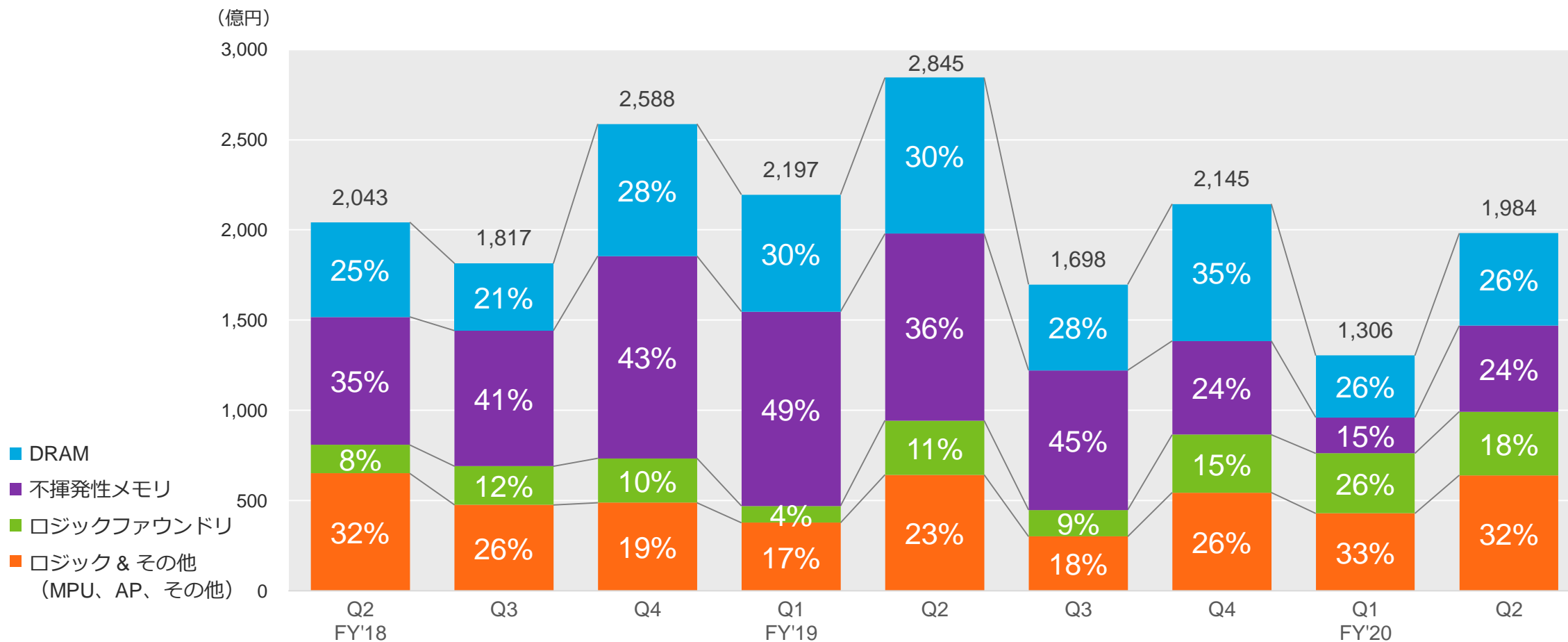
SPE部門 地域別売上高（四半期）

(億円)
4,000



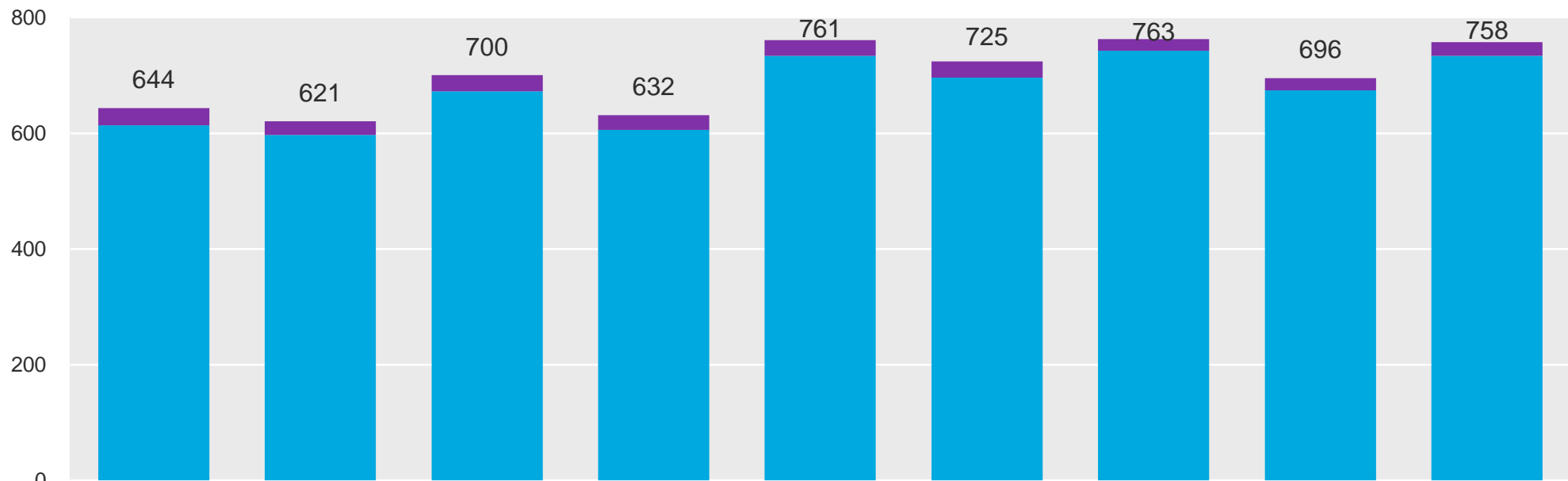
	Q2 FY'18	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2
日本	384	351	451	511	580	540	427	325	410
北米	320	291	339	284	459	227	347	285	588
欧州	269	196	250	177	313	186	253	202	144
韓国	1,017	794	1,223	889	865	609	689	369	364
台湾	366	421	443	263	480	293	591	483	487
中国	230	226	318	549	713	380	425	270	568
東南アジア・他	67	132	234	127	168	156	152	44	155

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)

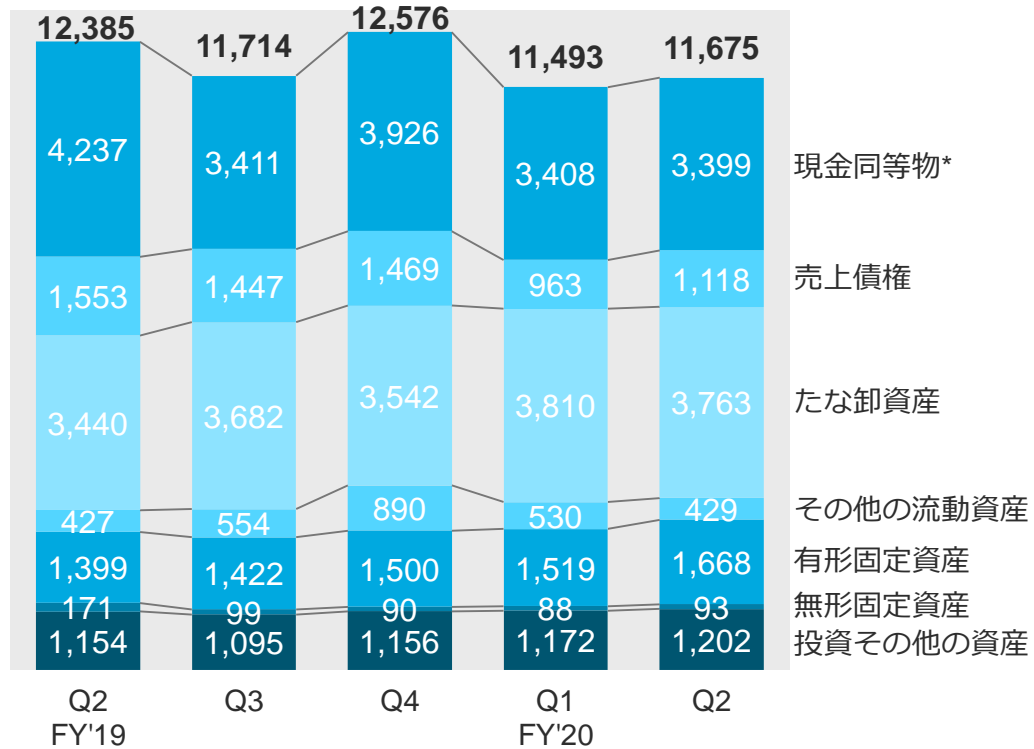


	Q2 FY'18	Q3 FY'18	Q4 FY'18	Q1 FY'19	Q2 FY'19	Q3 FY'19	Q4 FY'19	Q1 FY'20	Q2 FY'20
SPE売上高	614	597	672	606	734	696	742	674	734
FPD売上高	29	24	28	25	27	28	21	21	23

貸借対照表（四半期）

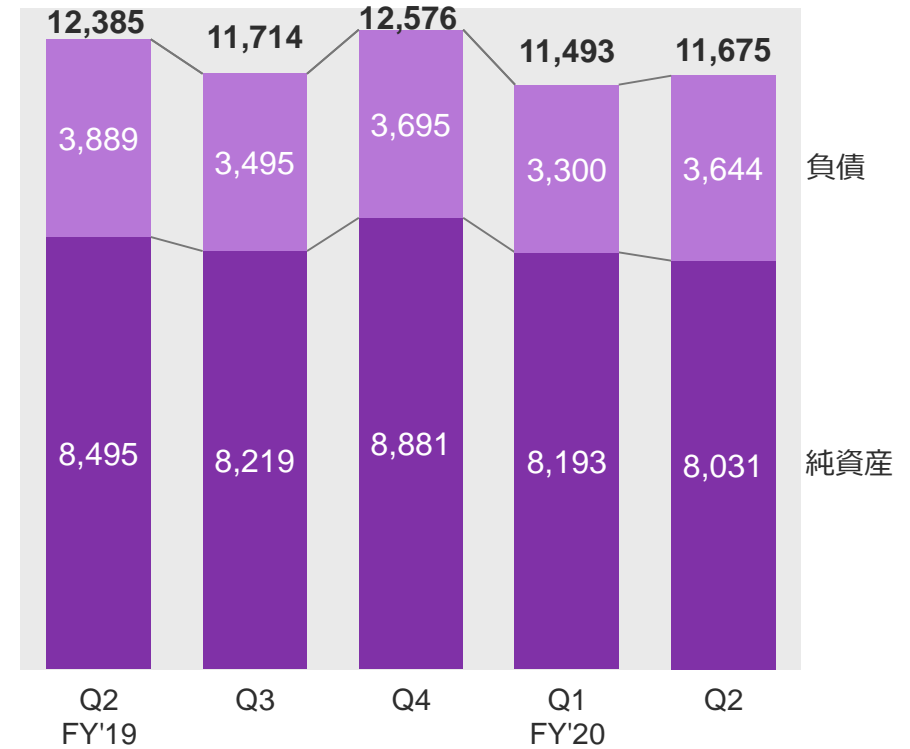
資産

(億円)

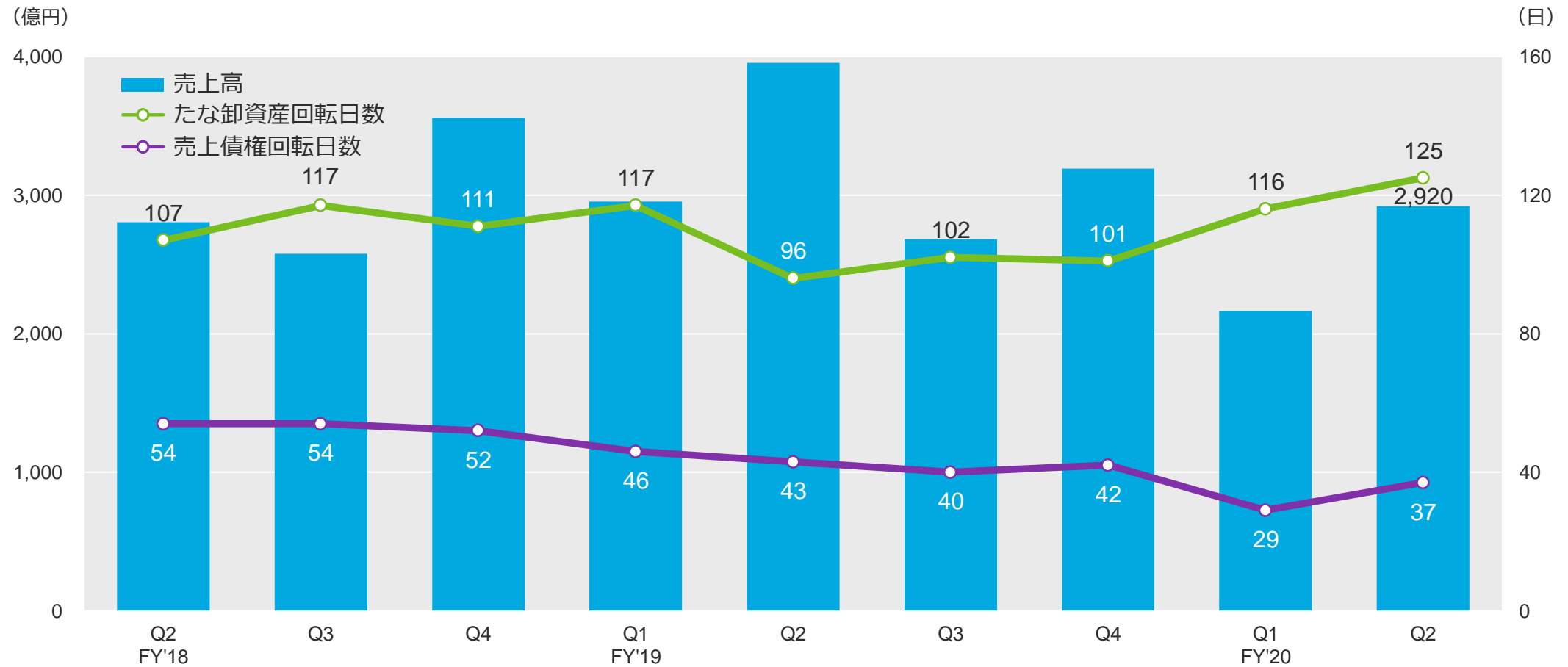


負債・純資産

(億円)

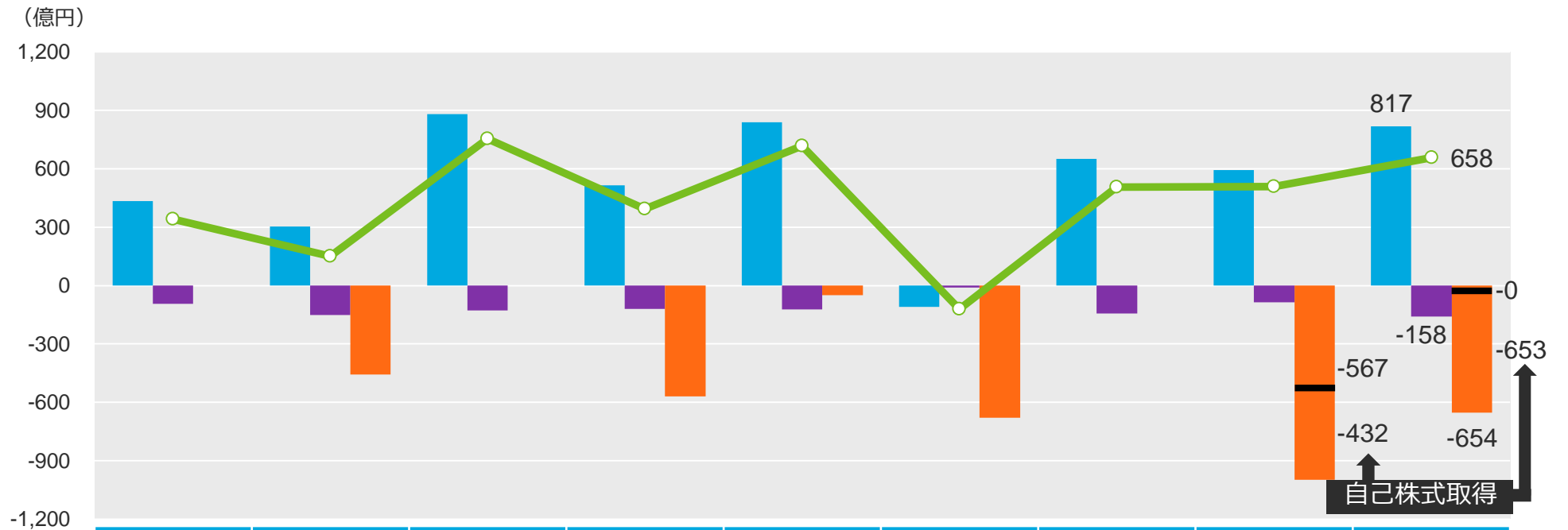


たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー（四半期）



	Q2 FY'18	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2
営業キャッシュ・フロー	434	304	881	514	840	-110	650	594	817
投資キャッシュ・フロー*1	-94	-152	-128	-121	-122	-11	-144	-85	-158
財務キャッシュ・フロー	-0	-457	-0	-569	-50	-678	-0	-999	-654
フリーキャッシュ・フロー*2	340	151	753	393	717	-121	505	509	658
手元資金残高*3	3,299	3,012	3,738	3,555	4,237	3,411	3,926	3,408	3,399

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

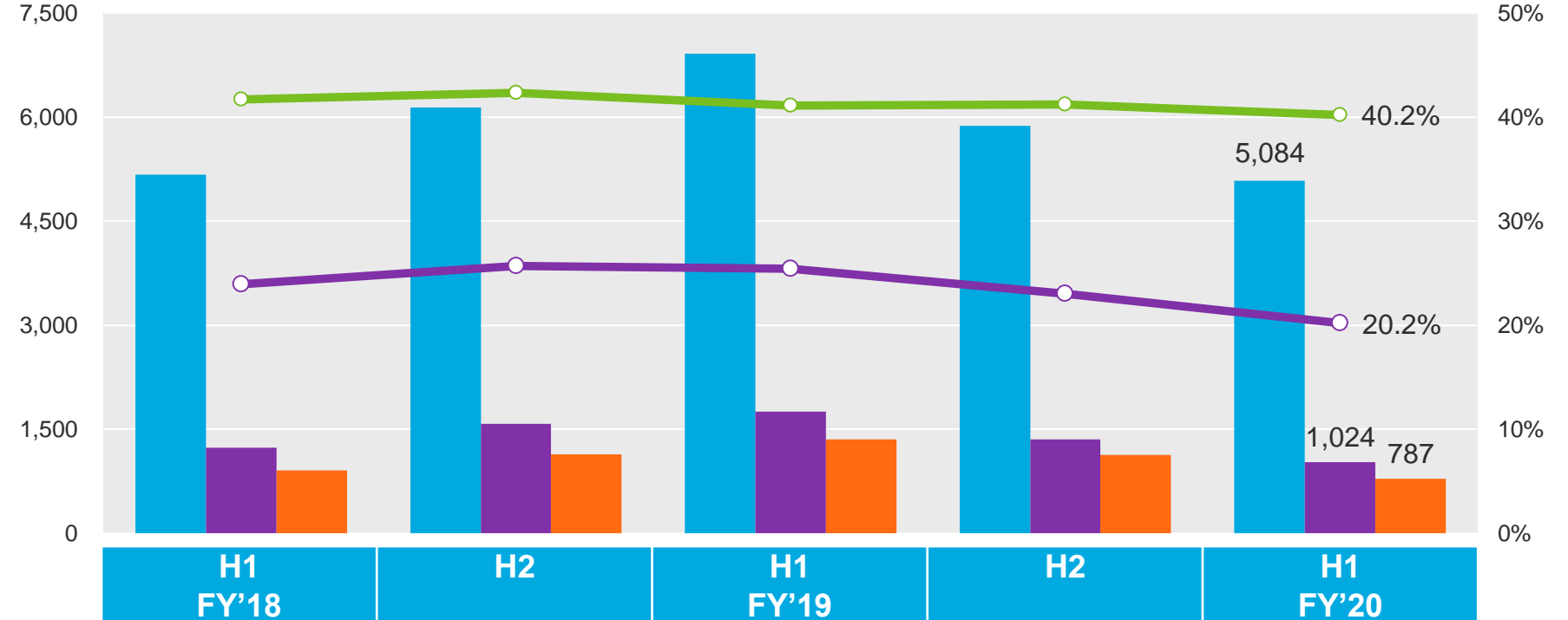
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

Appendix

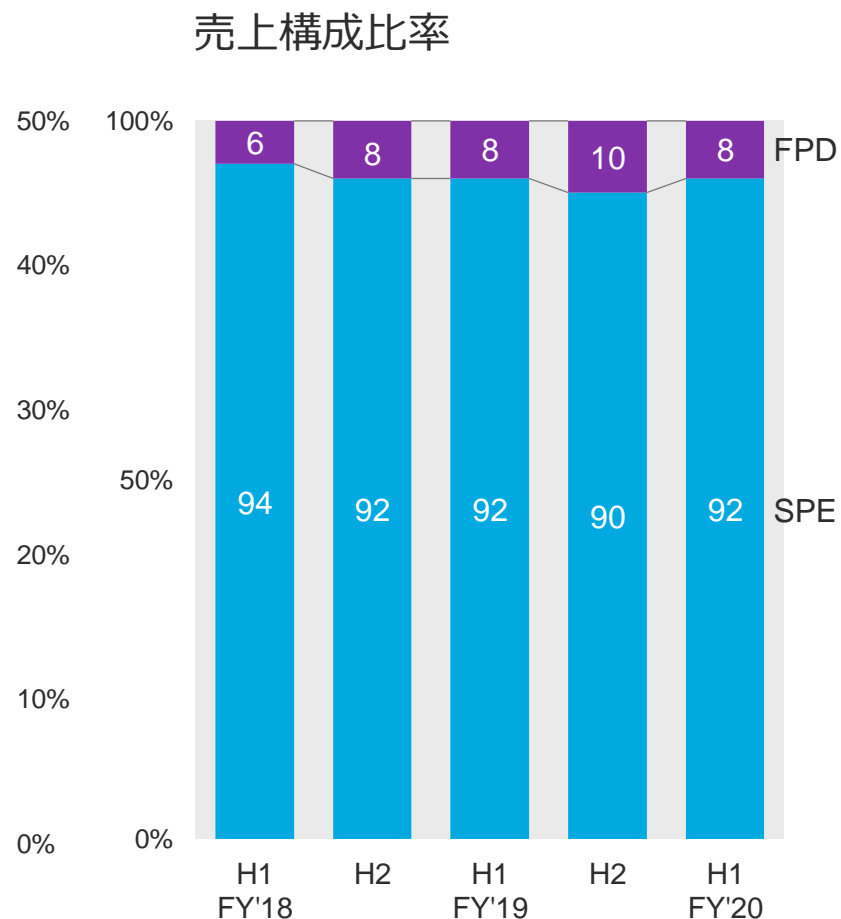
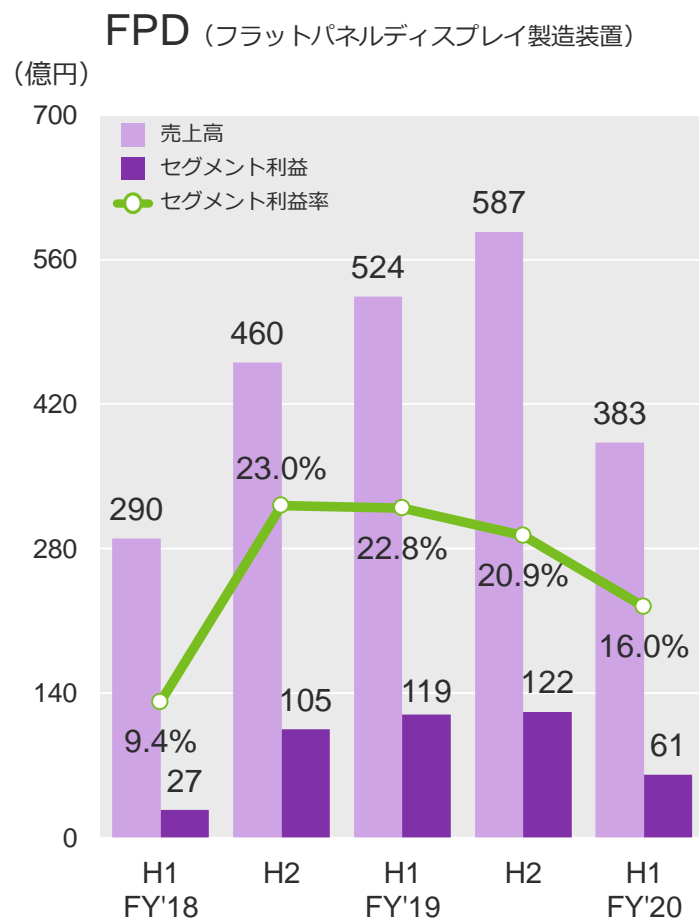
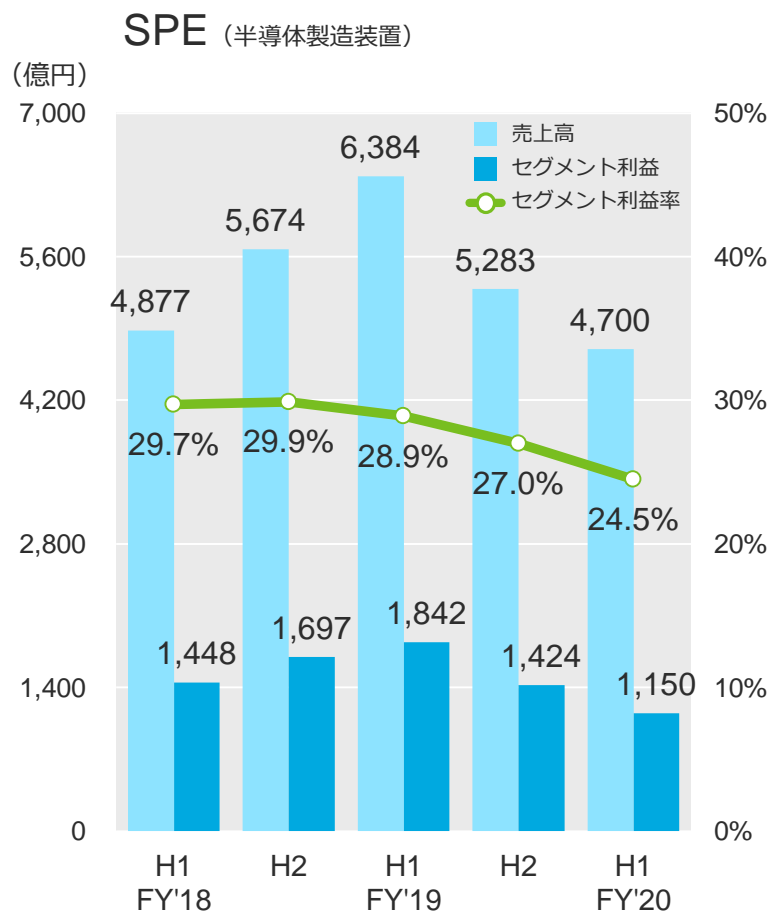
損益状況（半期）

(億円)
7,500



売上高	5,169	6,137	6,910	5,872	5,084
営業利益	1,233	1,578	1,754	1,351	1,024
親会社株主に帰属する当期純利益	906	1,137	1,352	1,129	787
売上総利益率	41.7%	42.3%	41.1%	41.2%	40.2%
営業利益率	23.9%	25.7%	25.4%	23.0%	20.2%

セグメント情報（半期）

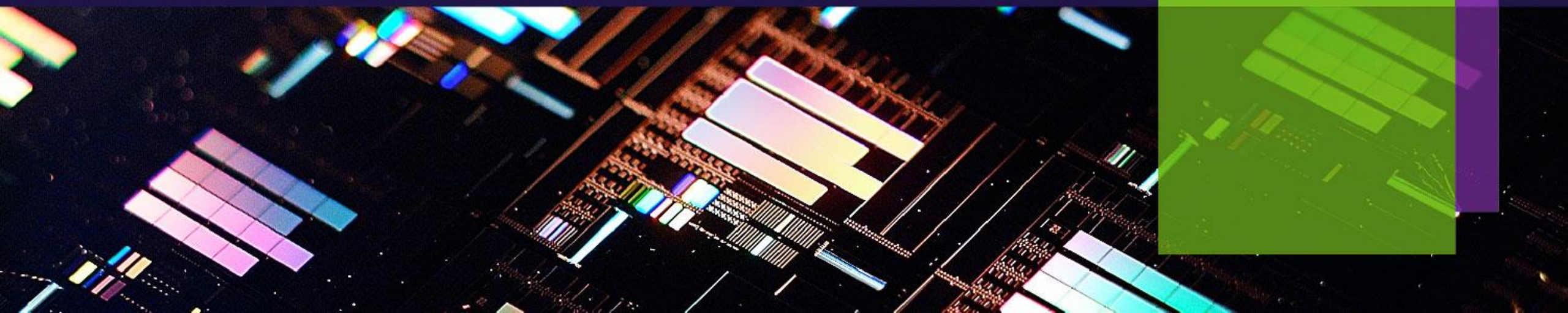


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

事業環境および業績予想修正

2019年10月31日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2019年10月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2019の投資は、従前通り、前年比15～20%程度の減少で着地の見込み。ロジック/ファウンドリ向けは堅調、メモリは在庫調整が進み、CY2020に投資回復を予想

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2019は、モバイル用中小型および大型パネル向け投資の調整により、前年比30%程度減少も、期待していた通り年後半から投資は回復基調

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2019 アプリケーション別のWFE市場の見通し

FY2020 Q1決算発表時から市場の見方に変更なし

- ロジック/ファウンドリ：前年比35%程度増加
 - 市場環境：世代移行による設備投資増加。10nm以細の世代向けが5割を占める
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- 不揮発性メモリ：前年比60%程度減少
 - 市場環境：歩留まり向上により生産能力の増強投資は調整中だが、在庫は減少方向へ。9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化
- DRAM：前年比40%程度減少
 - 市場環境：設備投資の約6割が1Y/1Znm世代向け
 - 事業機会：最先端世代における一括パターンニング

CY2019のメモリ向け投資は抑制されるも、CY2020に回復する見込み

FY2020 事業進捗 (Q2)

■ SPEの事業戦略は計画通り進捗

- 注力分野で POR*1の獲得が進む
 - エッチング : Q1に引き続き、IoT・Automotive分野でPOR獲得
 - 成膜 : 最先端ロジックにおいて、ALDおよびバッチ成膜工程のPOR獲得
 - 洗浄 : ベベル洗浄の展開が順調に進捗、新規顧客から受注
- BRIDG*2に200mmデモ装置導入、AutomotiveやIndustry向けの半導体製造装置やプロセス技術開発のための環境を整備

■ FPD製造装置の新製品の販売開始

- 開発ライン向けの有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置Elius™500 Proをリリース

*1 POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 BRIDG (Bridging the Innovation Development Gap) : 米国フロリダ州にある非営利のコンソーシアム

FY2020 業績予想修正

FY2020 業績予想修正

(億円)

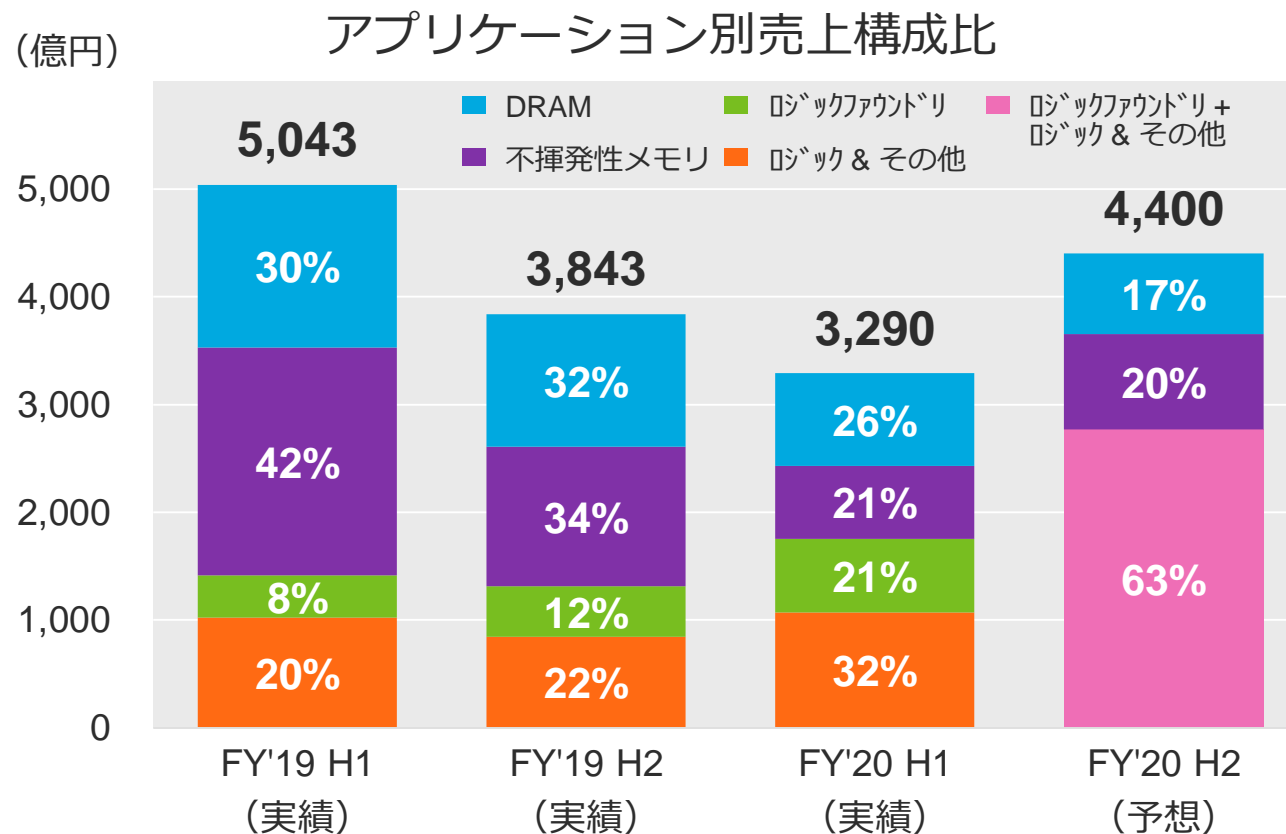
	FY2019 (実績)	FY2020 (予想)					通期 対前年増減
		H1	H2	通期			
		実績	新予想	新予想	修正額*1		
売上高	12,782	5,084	6,015	11,100	+100	-13.2%	
SPE	11,667	4,700	5,649	10,350	+50	-11.3%	
FPD	1,112	383	364	748	+48	-32.8%	
売上総利益 下段：売上総利益率	5,261 41.2%	2,045 40.2%	2,404 40.0%	4,450 40.1%	+40 0pts	-811 -1.1pts	
販管費	2,156	1,020	1,179	2,200	-10	+43	
営業利益 下段：営業利益率	3,105 24.3%	1,024 20.2%	1,225 20.4%	2,250 20.3%	+50 +0.3pts	-855 -4.0pts	
税金等調整前当期純利益	3,215	1,066	1,223	2,290	+90	-925	
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,482	787	912	1,700	+60	-782	
1株当たり当期純利益 (円)	1,513.58	490.18	-	1,068.83	+53.62	-444.75	

期初計画に対し、売上前倒し。通期業績予想を修正

*1 修正額：2019年4月26日に発表した業績予想からの修正額を示しています。

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

FY2020 SPE部門 新規装置売上予想

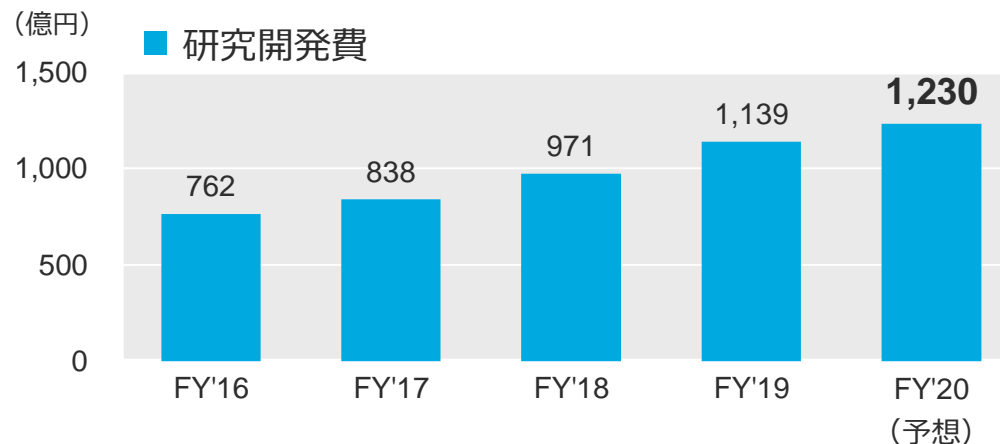


上期は下期計画分の一部前倒し
 下期はロジック・ファウンドリ向け売上が大きく伸長

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

FY2020 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,230億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 330億円



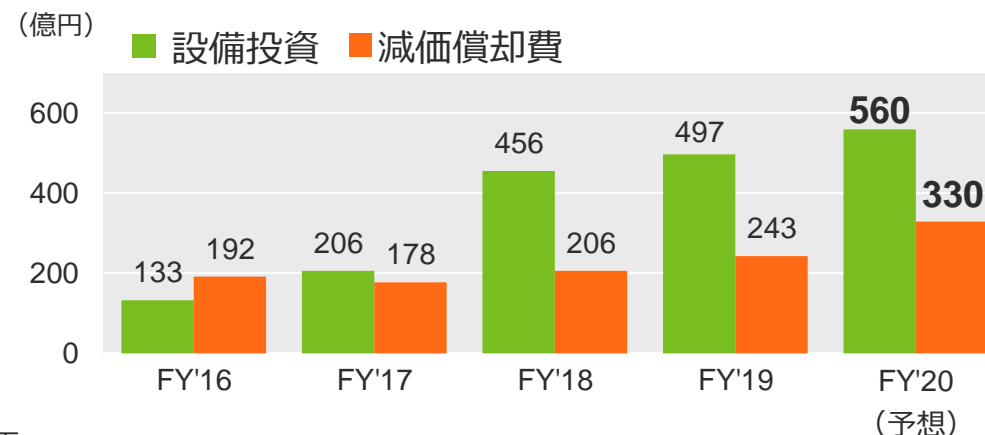
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士吉野市：建設費約130億円
(2019年2月着工、2020年4月竣工予定)

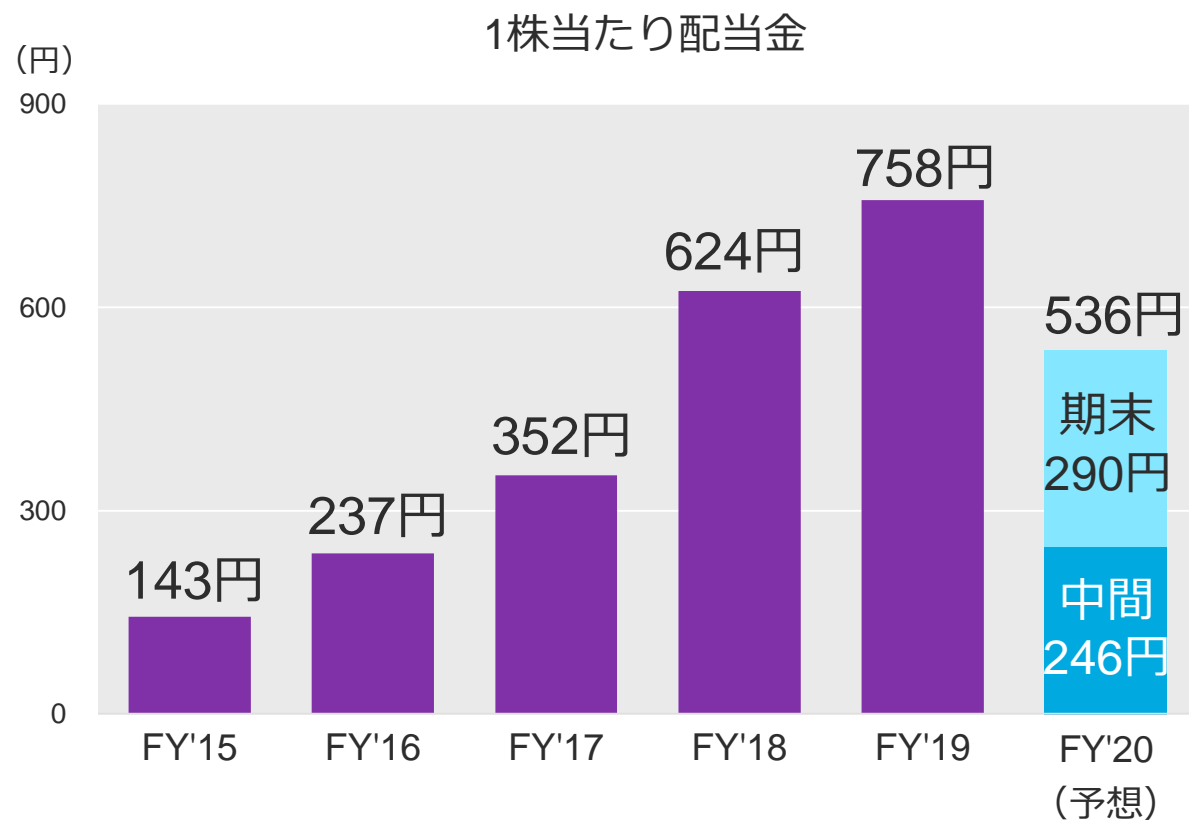


岩手県奥州市：建設費約130億円
(2018年10月着工、1期工事 2019年10月竣工、
2期工事 2020年11月竣工予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2020 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

中間配当は上期の自己株式取得実績を反映、
期末配当は下期の自己株式取得に応じて修正

TEL™

TOKYO ELECTRON